



関係各位

ISSM 組織委員会委員長
株式会社デバイス&システム・プラットフォーム開発センター
代表取締役会長兼社長 齋藤 昇三
ISSM 組織委員会副委員長
アトナープ株式会社
アドバイザー 井上 修一
ISSM 運営委員会委員長
東芝ナノアナリシス株式会社
技師長 嶋崎 綾子

第 30 回半導体生産技術国際シンポジウム「ISSM2024」協賛募金のお願いについて

拝啓 ますますご清祥の段、心よりお慶び申し上げます。

平素は、ISSM(半導体生産技術国際シンポジウム)にご厚情を賜りまして誠に有難うございます。

ISSM は 1992 年発足以来、皆様のご支援を賜り、これまでの 29 回の実績から半導体生産技術に関する最も重要な国際会議の一つとして認知をいただき、半導体生産におけるメジャー会議としての位置づけを確立しております。

昨今、ISSM のテーマである半導体製造技術は、「作る技術」から「使う技術」へのシフトが益々重要となつてきております。半導体製造技術全体を広く捉えて技術を評価し選択していくことが必要な今、ISSM は半導体製造全般の技術を網羅している特徴を活かし、異なる技術分野を統合化するシステム的なアプローチを評価できる唯一の国際会議として、半導体製造の発展に一層寄与していきたいと考えます。

技術面に加えまして、SCM 軸での地勢的な原材料の調達・リユース課題や、最終ユーザーからの脱炭素世界に準じた生産技術の対応課題なども、新たな変化として浸透しております。

第 30 回を迎える、ISSM2024 は、半導体生産技術の新たな課題にむけて、半導体産業界の有益な協調を推し進め、延いては半導体産業の新たな飛躍に資すること、また半導体産業の永続的な発展と繁栄に資することを旨として、2024 年 12 月 9 日(月)～10 日(火)に、KFC ホール(東京・両国)での開催を予定しております。

シンポジウムの開催は参加費にて運営されることが本来の姿と考え、参加者にとって魅力ある企画の推進に努めておりますが、半導体の将来を担う若手技術者並びに学生の参加を積極的に募るには、低めの参加費、もしくは無料の設定も必要と考えております。経費の大幅な節減を行いましても、参加費のみでシンポジウムを開催することは至難な状況です。

ISSM2024 に何卒、ご支援を頂きたく、ご寄付(協賛募金)にご協力賜りますようお願い申し上げます。なお、講演論文の募集につきましてもあらためましてご依頼を申し上げますので、重ねましてよろしくお願ひ申し上げます。

敬 具

ISSM2024 大綱

1. 会議の名称

(和文名称) 第30回半導体生産技術国際シンポジウム 2024

(英文名称) International Symposium on Semiconductor Manufacturing 2024

(略称) ISSM2024

2. 支援機関などの名称(予定)

Co-sponsored by:

IEEE Electron Devices Society

Minimal Fab

Semiconductor Equipment Association of Japan (SEAJ)

Semiconductor Equipment and Materials International (SEMI)

Taiwan Semiconductor Industry Association (TSIA)

Endorsement by:

The Japan Society of Applied Physics

3. 会期と開催地(予定)

(1)会期:2024年12月9日(月)ー10日(火)

(2)開催地:KFC ホール(東京・両国)

4. ISSM2024 会議の概要

(ア) 会議日程 2024年12月9日(月)ー10日(火)

(イ) 会議内容(予定)

① キーノートセッション(基調講演)

② ハイライトセッション

③ オーラルプレゼンテーションセッション(一般講演)

④ インターラクティブ・ポスターセッション

⑤ チュートリアルセッション

(ウ) 会議の主題:半導体生産技術

① Fab Management

・工場設計(FD)

・搬送自動化及び管理(MH)

・製造ライン戦略及び運営管理(MS)

・工場ラインオペレーション手法(FO)

・環境・安全・健康・脱炭素(ES)

・オペレータ及びWIP制御(WC)

・工場データ管理(ID)

② Material Technology

・新ガス・新薬液・新レジスト技術(NM)

・マテリアルインフォマテックス(MI)

・製造装置向け新パーツ(NP)

③ Process Integration

・プロセス及び材料の最適化(PO)

・プロセスモニタリング・制御手法(PM)

・歩留まり及び欠陥制御(YD)

・ウルトラクリーンテクノロジー(UT)

・新プロセス装置・測定装置(PE)

・新規デバイス向け製造技術(VD)

④ Final Manufacturing & Packaging

・ヘテロジニアスインテグレーション及び新パッケージング技術(HI)

・パッケージング及び実装技術改善(FM)

・シグナルインテグリティ及びパワーインテグリティ(SI)

(エ) 同時開催予定イベント

① ISSM AI 技術コンテスト(予定)

(オ) 参加予定国:日本, 米国, 欧州諸国, アジア諸国, その他

(カ) 参加予定者

日本、欧米、アジアなどから 250 名

(キ) 会議公用語

講演 英語

印刷物 英語

【ISSM2024 協賛金特典内容】

種別	プラチナ	ゴールド	シルバー	ブロンズ	レセプション	ストラップ
募集上限	—	—	—	—	2	1
協賛金(税別)	¥800,000	¥600,000	¥400,000	¥200,000	¥400,000	¥200,000
ISSM 参加						
ISSM2024への無料参加人数						
ISSM2024参加費 (予定)						
一般参加 (早期申込割引) 40,000円	6	4	2	1	1	1
一般参加 (通常・当日) 50,000円						
学生 (予稿集無し) 無料						
学生 (予稿集有り) 3,000円						
Visibility						
ISSM2024ウェブサイト (ロゴから企業HPへリンク)	上段	中段 (上)	中段 (下)	下段	下段	下段
キーノート前に1分間のPR動画投影 (希望ベース)	有	有	無	無	無	無
予稿集にロゴ掲載、ホームページへリンク	有	有	有	有	有	有
インターバルスクリーン上にロゴを表示	有	有	有	有	有	有
会場ポスターにロゴを表示	有	有	有	有	有	有
レセプション会場にロゴを表示	無	無	無	無	有	無
レセプションでのスピーチ	無	無	無	無	有	無
ストラップに企業名を表示	無	無	無	無	無	有
テーブルトップ展示						
展示をご希望の場合下記をご用意いたします。 テーブル1800W×450D×720H バックパネル (3つ折) 1800W×1800H 椅子1脚 ・電源(100V500W)をご希望の場合は、 5,500円 (税込) の追加料金となります	有	有	有	有	無	無
展示期間: 12月9日、10日 設営: 12/9朝、撤去: 12/10午後						

※テーブルトップ展示・ポスターへのロゴ掲載は 10 月末までが特典お申込みの期限となります。

■ISSM 事務局

株式会社セミコンダクタポータル

〒105-0001 東京都港区虎ノ門 1-16-4 アーバン虎ノ門ビル 6F

Tel: 03-6807-3970 Fax: 03-6807-3960

E-mail: issm_2024@semiconportal.com